

平成 20 年 11 月 4 日

お客様各位

東京エレクトロンデバイス株式会社
インレビウム事業部 技術支援部

湯浅 剛

ITS
20.11.04

湯浅

【お詫び】TE7760PF 成分表の相違について

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたくお礼申し上げます。

さて表題の件につき、この度、当初に提出させて頂いた、当該 IC の成分表に間違いがある旨 IC 製造メーカーより連絡がございました。謹んでお詫び申し上げますと共に、現在は書類を提出する専門部署を設け、完全システム化をし再発防止に努めてまいりますので、何卒ご容赦の程重ねてお願い申し上げます。ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

敬具

記

1. 該当IC: TE7760PF

2. 内容:

①この度、TE7760PFのハロゲンフリー化をする旨貴社にご連絡致しましたが、実際は弊社に最初に納入されたものから既にハロゲンフリー化されており、その際にIC製造メーカーより入手した成分表が間違っていた事が判明しました。

成分表正誤表

部位	誤り	正しい（現行品：ハロゲンフリー品）
封止樹脂	Sb203（三酸化アンチモン）	—（未使用）
	有機リン化合物	有機リン化合物
	臭素系難燃剤	—（未使用）
	フェノール化合物	—（未使用）
	SiO2（シリカ）	SiO2（シリカ）
	カーボンブラック	カーボンブラック
	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂

②今回、リード材質の変更（Fe合金からCu合金）を実施いたします。

リード材質変更による変更表

部位	現行品（ハロゲンフリー品） 添付：K-1-TE7760PF	リード材質変更後（ハロゲンフリー品） 添付：K-2-TE7760PF
リードフレーム	ニッケル	—（未使用）
	鉄	—（未使用）
	銀	銀
	—（未使用）	銅

写し）インレビウム営業部 部長 千野

インレビウム営業部 グループリーダー 武藤

以上

製品に含まれる化学物質情報

1. 対象製品： TE7760PF
2. 製品質量： 1.2g
3. 上記製品 1 個当りに含有する化学物質は、下表の内容です。

No.	部位	CAS-NO	物質名	含有量(mg)	含有率(%)
1	ダイ付け剤	7440-22-4	銀	2.5	0.208333333
2	リード外装メッキ	7440-69-9	ビスマス	0.24	0.02
3	リード外装メッキ	7440-31-5	錫	12	1
4	封止樹脂		有機リン化合物	39.79	3.315833333
5	封止樹脂	7631-86-9	シリカ	902.9	75.24166667
6	封止樹脂	1333-86-4	カーボンブラック	1.99	0.165833333
7	封止樹脂		エポキシ樹脂	49.73	4.144166667
8	リードフレーム	7440-02-0	ニッケル	65.59	5.465833333
9	リードフレーム	7439-89-6	鉄	90.58	7.548333333
10	リードフレーム	7440-22-4	銀	13	1.083333333
11	ワイヤー	7440-57-5	金	5.14	0.428333333
12	チップ	7440-21-3	シリコン	16.54	1.378333333

※砒素はチップ中にイオン化し打ち込み、素子材料として含有していますが、微量の為表からは除外しています。チップ全面に打ち込む（現実には有り得ませんが、理論上の最大値）と仮定して、チップ重量に対し 11ppm の含有となります。

製品に含まれる化学物質情報

1. 対象製品： TE7760PF
2. 製品質量： 1.2g
3. 上記製品 1 個当りに含有する化学物質は、下表の内容です。

No.	部位	CAS-NO	物質名	含有量(mg)	含有率(%)
1	ダイ付け剤	7440-22-4	銀	2.96	0.246666667
2	リード外装メッキ	7440-69-9	ビスマス	0.24	0.02
3	リード外装メッキ	7440-31-5	錫	12	1
4	封止樹脂		有機リン化合物	39.68	3.306666667
5	封止樹脂	7631-86-9	シリカ	901.55	75.12916667
6	封止樹脂	1333-86-4	カーボンブラック	1.98	0.165
7	封止樹脂		エポキシ樹脂	49.6	4.133333333
8	リードフレーム	7440-50-8	銅	161.23	13.43583333
9	リードフレーム	7440-22-4	銀	6	0.5
10	ワイヤー	7440-57-5	金	5.14	0.428333333
11	チップ	7440-21-3	シリコン	19.62	1.635

※砒素はチップ中にイオン化し打ち込み、素子材料として含有していますが、微量の為表からは除外しています。チップ全面に打ち込む（現実には有り得ませんが、理論上の最大値）と仮定して、チップ重量に対し 11ppm の含有となります。